

マーケットインの視点を強化し、 長期経営計画「2025年ビジョン」 の実現を加速

当社の営業体制は、これまでSBU^{*1}体制に基づき、各事業部に所属する営業部門がその製品の販売を担当する形で進めてきました。これは、当社がグローバル各地域に事業を拡大し、横串で事業を統制する上で、成果を上げてきました。当社は世界をリードする3つの製品(ACサーボ・インバータ・ロボット)を持ち、「技術立社」として発展を遂げてきましたが、インダストリ4.0やIoTなどの実現に向け、お客様のニーズが大きく変化する中で、これまでの技術視点による事業展開のみでは対応しきれない領域が拡大しています。そのため、今後の事業運営は、よりマーケットインの視点に立った製品・サービスの提供が必須と考えています。

この課題に対し、当社は2017年度からIMM^{*2}制度を導入し、営業力強化への取り組みを開始しました。IMM制度は、これまでの事業・製品別の販売にこだわらず、産業・アプリケーション別の視点からオール安川のソリューションを提供する事業横断的な取り組みです。まずは、新市場である食品・中食市場とシェア拡大が遅れている半導体市場でチャレンジを開始しました。

本来、営業はお客様のニーズを収集し、それを社内に伝達し、事業の方向性を変化させていく役割を担っていますが、これをより機能させるには、ニーズの背景にあるお客様の事業の方向性を理解する必要があります。そして、その情報を社内でも共有し、自社の事業戦略に反映させることで、製品開発につなげることが重要です。当社は、「技術立社」として発展してきた経緯から、このマーケットイン視点からの営業遂行力に大きな課題があると感じており、能力強化に取り組みます。

このようにIMM制度の導入により、営業人材のレベルアップを図り、経営におけるマーケットイン視点からの営業遂行力をさらに強化させることで、長期経営計画「2025年ビジョン」の目標達成に向けた成長を加速させていきます。

*1 SBU:Strategic Business Unitの略。事業計画を戦略的に立案・遂行することを目的とした組織単位。当社グループのSBUは製品カテゴリによる。

*2 IMM:Industry Marketing Managementの略。特定市場における事業部横断的なマーケティング、営業体制を構築することで、グローバル市場でのマーケティング・営業力を強化する取り組み。

取締役 常務執行役員
マーケティング本部長
マーケティング本部 東京支社長

高宮 浩一

半導体市場における取り組み

当社は半導体市場向けにウエハ搬送用ロボットと、製造装置などに組み込むACサーボをお客様に提供しています。数年前まではパソコンの需要に連動し、半導体市場の変動が激しかったため、経営の舵取りが非常に難しい状況にありました。このため、ロボット事業においては、拡大戦略よりも安定した収益確保を優先してきました。しかし、近年においてはスマートフォン・タブレット端末・電気自動車（EV）などアプリケーションの拡大に合わせ、高い水準で需要が安定化するなど、市場環境は大きく変化してきています。そして、IoT時代の到来に向けデータセンタなどのインフラ投資も活発化していることから、今後も安定した需要が見込まれています。

この需要に対応するため、半導体市場向けにIMM制度を導入し、事業部別の販売機能を統合した営業活動を開始しました。現在は、お客様のご要望・課題・市場の状況などを共有・把

握するため、トップ営業によるお客様との面談を開始し、事業目標の再設定を行っています。まずは、日本・米国を中心とした既存のお客様へのヒアリングに基づいた戦略の再構築を図り、次期中期経営計画における本格的なグローバル展開の加速を図っていきます。



ACサーボ[2-7]シリーズ



半導体ウエハ搬送ロボット

食品市場における取り組み

当社は、大きなポテンシャルがある食品市場の自動化ソリューションの提供に向けて、約2年前から日本市場での取り組みを開始しました。この分野では、食品加工工程の上流から下流までを自動化することを目指し、ビジネスモデルの構築にチャレンジしています。上流では植物工場による野菜の生産自動化、中流では自動化が遅れているお弁当・総菜などの中食製造の自動化、下流ではPPP^{*3}用途のロボットにより出荷に至るまでの工程の自動化に取り組んでいます。

今年度は、植物工場の具体的なシステム構築を行い、現中期経営計画期間中に、中食製造分野向けのソリューション開発を行います。また、PPP用途ロボットについては既存のお客様へのヒアリングを継続し、ラインアップに反映させていく予定です。

現在の食品業界では、生産のトレーサビリティが課題となっており、効率的な生産自動

化システムの構築が実現できていません。ここに当社IoT技術を連携させることができれば、大きなビジネスポテンシャルがあるとみています。

このように、当社製品・技術を結集したソリューションの提供を進めると同時に、基幹システムと連携させた付加価値の高いビジネスへの発展も視野に入れ、新しい市場の開拓を進めていきます。

*3: Picking Packing Palletizingの略。



番重詰めロボット



トッピングロボット